



**BOSCH**

25. Juni 2018  
RF 10679-d Ka/af

**Deutschland kann Hightech:**

**Halbleiter sind der Grundstein für mehr Lebensqualität**

Statement von Dr. Dirk Hoheisel,

Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

anlässlich der Pressekonferenz zur Grundsteinlegung

des 300-Millimeter-Halbleiterwerks Dresden am 25.06.2018

Es gilt das gesprochene Wort.

Robert Bosch GmbH  
Postfach 10 60 50  
70049 Stuttgart

Corporate Communications  
and Brand Management  
E-Mail: [Sven.Kahn@bosch.com](mailto:Sven.Kahn@bosch.com)  
Telefon: +49 711 811-6415  
Twitter: @BoschPresse

Leitung: Dr. Christoph Zemelka  
[www.bosch-presse.de](http://www.bosch-presse.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor nur fast einem Jahr haben wir gemeinsam die Entscheidung zum Bau unserer neuen 300-Millimeter-Halbleiterfabrik bekannt geben – heute können wir nach komplexen Planungsschritten den Grundstein für die Chipfabrik der Zukunft von Bosch legen. Wir legen damit zugleich den Grundstein für mehr Lebensqualität der Menschen, wir legen den Grundstein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr – und wir legen den Grundstein für eine Schlüsseltechnologie des Internets der Dinge sowie der Mobilität der Zukunft.

Halbleiter sind Kernbestandteil aller elektrischen Systeme. Und Halbleiter machen Daten auch zum begehrten Rohstoff der Zukunft – ohne Halbleiter würde heute kein Auto mehr fahren. Sie ermöglichen automatisiertes, ressourcenschonendes Fahren und sorgen für bestmöglichen Insassenschutz – etwa beim Auslösen eines Airbags. Für die immer größeren Anwendungsfelder von Halbleitern erweitern wir unsere Fertigungskapazitäten und setzen für unser neues Werk auf den Technologiestandort Deutschland. Mit dem Neubau steigen wir erstmals in die 300-Millimeter-Technologie ein, um weitere Skaleneffekte zu erzielen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Landeshauptstadt Dresden ist für uns ein Motor der Mikroelektronik in Europa – und war damit weltweit die erste Wahl für unsere Milliardeninvestition. Ich bin überzeugt: Deutschland kann Hightech. Durch eine enge Kooperation mit Halbleiterunternehmen, Wissenschaft und Lehre wollen wir sowohl unsere Innovationskraft als auch die Wettbewerbsfähigkeit dieser Hochtechnologiebranche stärken – in Deutschland und in Europa.

Meine Damen und Herren, in unserer Chipfabrik schaffen wir mit hochautomatisierten Fertigungsprozessen täglich nicht nur Zukunft in Form von Halbleiter. Wir schaffen ebenso die Zukunft für hochattraktive Arbeitsplätze. In unserem Hightech-Werk sollen künftig bis zu 700 Mitarbeiter tätig sein. Wir suchen kreative Köpfe, die den Bau der modernsten Chipfabrik von Bosch mitgestalten. Dazu setzen wir stark auf Fachkräfte aus der Region, aber auch auf internationale Kompetenzträger und Experten.

Unser neues Bauvorhaben ist zugleich die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Bosch. Wir investieren rund eine Milliarde in unseren neuen Standort und freuen uns, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beabsichtigt, die Einrichtung und Inbetriebnahme zu unterstützen. Neben der Bundesregierung haben auch das Land Sachsen und die Stadt Dresden Unterstützung zugesichert. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Bundesminister Altmaier, und auch bei Ihnen, Herr Ministerpräsident Kretschmer. Sie und Ihre Vorgänger haben dazu beigetragen, dass wir heute gemeinsam bereits den symbolischen Grundstein legen können – für mehr Lebensqualität der Menschen, für die Halbleiterbranche in Dresden und für die Wettbewerbsfähigkeit des Technologiestandortes Deutschland.